



2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年7月9日

上場会社名 ローツェ株式会社 上場取引所 東
 コード番号 6323 URL <https://www.rorze.com>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 藤代 祥之
 問合せ先責任者 (役職名) 管理部長 (氏名) 伊勢村 英一 (TEL) 084-960-0001
 配当支払開始予定日 —
 決算補足説明資料作成の有無 : 有
 決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2027年2月期第1四半期の連結業績(2026年3月1日～2026年5月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2027年2月期第1四半期	37,206	12.5	10,230	21.2	10,938	51.1	8,210	56.0
2026年2月期第1四半期	33,061	12.9	8,441	△3.5	7,241	△36.3	5,263	△40.0

(注) 包括利益 2027年2月期第1四半期 8,692百万円 (—%) 2026年2月期第1四半期 △317百万円 (—%)

	1株当たり 四半期純利益		潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益	
	円	銭	円	銭
2027年2月期第1四半期	47	34	47	34
2026年2月期第1四半期	29	91	29	90

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2027年2月期第1四半期	201,633	145,657	67.8
2026年2月期	197,302	139,961	66.0

(参考) 自己資本 2027年2月期第1四半期 136,643百万円 2026年2月期 130,228百万円

2. 配当の状況

	年間配当金					
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計	
	円	銭	円	銭	円	銭
2026年2月期	—	0.00	—	17.00	17.00	—
2027年2月期	—	—	—	—	—	—
2027年2月期(予想)	—	0.00	—	20.00	20.00	—

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2027年2月期の連結業績予想(2026年3月1日～2027年2月28日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
第2四半期(累計)	77,634	18.3	19,088	17.7	19,168	31.5	13,809	27.0	79	26
通期	159,021	23.5	38,112	22.3	38,241	17.2	27,809	46.0	159	62

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 無
新規 社 (社名) 、除外 社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)	2027年2月期1Q	176,400,000株	2026年2月期	176,400,000株
② 期末自己株式数	2027年2月期1Q	2,968,260株	2026年2月期	2,968,260株
③ 期中平均株式数 (四半期累計)	2027年2月期1Q	173,431,740株	2026年2月期1Q	176,012,060株

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー : 無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述について)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料2ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
(四半期連結損益計算書)	5
(四半期連結包括利益計算書)	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(セグメント情報等)	7
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	8
3. 補足情報	9
生産、受注及び販売の状況	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間における我が国経済は、個人消費や企業の設備投資の持ち直しの動きが見られ、景気は緩やかな回復基調で推移しました。一方、世界経済におきましては、米国経済は堅調に推移しているものの、中東情勢の混迷により、先行きの不透明感が高く減速が懸念されています。

当業界におきましては、生成AIの需要拡大を背景にデータセンター向けの投資が引き続き拡大しており、これに伴い高性能・低消費電力の半導体技術への投資も加速しております。その結果、半導体市場全体としても引き続き堅調な成長が見込まれております。

当社グループにおきましては、半導体製造設備への投資が積極的に行われたことにより、主に米国、中国、台湾向けの半導体関連装置の販売が増加したこと及び為替の影響も加わり前年同期比で増収増益となりました。

この結果、当第1四半期連結累計期間の経営成績は売上高37,206百万円(前年同期比12.5%増)、営業利益10,230百万円(前年同期比21.2%増)、経常利益は為替の影響も受け、10,938百万円(前年同期比51.1%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益8,210百万円(前年同期比56.0%増)となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

半導体・FPD関連装置事業の売上高は37,075百万円(前年同期比12.5%増)、セグメント利益は10,834百万円(前年同期比23.3%増)となりました。

ライフサイエンス事業の売上高は131百万円(前年同期比18.8%増)、セグメント損失は119百万円(前年同期はセグメント損失110百万円)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

当第1四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ4,331百万円増加し、201,633百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加2,540百万円、受取手形及び売掛金の増加838百万円及び棚卸資産の増加981百万円によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ1,364百万円減少し、55,976百万円となりました。これは主に、借入金の減少1,731百万円によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ5,695百万円増加し、145,657百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増加5,261百万円によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2027年2月期の第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、2026年4月9日発表の「2026年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載しております予想数値から変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2026年2月28日)	当第1四半期連結会計期間 (2026年5月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	74,341	76,882
受取手形及び売掛金	32,413	33,252
商品及び製品	6,765	5,618
仕掛品	12,075	11,439
原材料及び貯蔵品	26,642	29,406
その他	2,906	3,619
貸倒引当金	△174	△157
流動資産合計	154,970	160,060
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	11,889	11,708
機械装置及び運搬具（純額）	5,439	5,223
土地	5,852	5,790
その他（純額）	2,714	2,974
有形固定資産合計	25,896	25,697
無形固定資産		
のれん	6,332	5,603
その他	2,884	2,838
無形固定資産合計	9,216	8,442
投資その他の資産		
投資有価証券	1,731	1,792
退職給付に係る資産	376	318
繰延税金資産	3,619	3,984
その他	1,551	1,398
貸倒引当金	△60	△60
投資その他の資産合計	7,218	7,433
固定資産合計	42,332	41,573
資産合計	197,302	201,633

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2026年2月28日)	当第1四半期連結会計期間 (2026年5月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	7,221	8,253
短期借入金	15,574	15,655
未払法人税等	5,207	5,453
前受金	3,932	2,548
賞与引当金	2,253	2,659
役員賞与引当金	19	4
製品保証引当金	1,852	1,809
その他	4,266	4,437
流動負債合計	40,328	40,822
固定負債		
長期借入金	8,207	6,395
役員退職慰労引当金	446	444
退職給付に係る負債	91	90
資産除去債務	362	374
繰延税金負債	287	234
訴訟損失引当金	7,429	7,429
その他	187	185
固定負債合計	17,012	15,154
負債合計	57,340	55,976
純資産の部		
株主資本		
資本金	982	982
資本剰余金	4,890	4,890
利益剰余金	115,771	121,033
自己株式	△5,043	△5,043
株主資本合計	116,600	121,862
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	332	298
為替換算調整勘定	13,295	14,482
その他の包括利益累計額合計	13,627	14,781
新株予約権	2	2
非支配株主持分	9,730	9,010
純資産合計	139,961	145,657
負債純資産合計	197,302	201,633

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2026年3月1日 至 2026年5月31日)
売上高	33,061	37,206
売上原価	19,632	21,166
売上総利益	13,429	16,039
販売費及び一般管理費	4,987	5,809
営業利益	8,441	10,230
営業外収益		
受取利息	84	32
為替差益	—	1,039
売電収入	15	4
その他	23	51
営業外収益合計	124	1,128
営業外費用		
支払利息	44	58
為替差損	1,229	—
売電費用	5	1
デリバティブ損失	28	347
その他	17	12
営業外費用合計	1,324	419
経常利益	7,241	10,938
特別利益		
固定資産売却益	12	2
特別利益合計	12	2
特別損失		
固定資産売却損	0	—
固定資産除却損	0	14
特別損失合計	0	14
税金等調整前四半期純利益	7,253	10,926
法人税、住民税及び事業税	2,538	3,466
法人税等調整額	△248	△449
法人税等合計	2,290	3,017
四半期純利益	4,963	7,909
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△300	△300
親会社株主に帰属する四半期純利益	5,263	8,210

(四半期連結包括利益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2026年3月1日 至 2026年5月31日)
四半期純利益	4,963	7,909
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△12	△33
為替換算調整勘定	△5,268	816
その他の包括利益合計	△5,281	783
四半期包括利益	△317	8,692
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	565	9,363
非支配株主に係る四半期包括利益	△882	△671

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間(自 2025年3月1日 至 2025年5月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	四半期 連結財務諸表 計上額 (注) 2
	半導体・ FPD関連 装置事業	ライフ サイエンス 事業	計		
売上高					
日本	2,199	106	2,305	—	2,305
台湾	9,575	—	9,575	—	9,575
中国	8,560	1	8,561	—	8,561
韓国	1,603	—	1,603	—	1,603
米国	8,202	2	8,204	—	8,204
その他	2,809	—	2,809	—	2,809
顧客との契約から生じる 収益	32,950	110	33,061	—	33,061
外部顧客への売上高	32,950	110	33,061	—	33,061
セグメント間の内部売上高 又は振替高	25	—	25	△25	—
計	32,976	110	33,086	△25	33,061
セグメント利益又は損失 (△)	8,786	△110	8,675	△234	8,441

(注) 1. セグメント利益又は損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用△234百万円であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3. 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

当第1四半期連結累計期間(自 2026年3月1日 至 2026年5月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	四半期 連結財務諸表 計上額 (注) 2
	半導体・ FPD関連 装置事業	ライフ サイエンス 事業	計		
売上高					
日本	2,155	123	2,278	—	2,278
台湾	9,986	—	9,986	—	9,986
中国	9,234	1	9,236	—	9,236
韓国	2,029	—	2,029	—	2,029
米国	11,062	6	11,068	—	11,068
その他	2,607	—	2,607	—	2,607
顧客との契約から生じる 収益	37,075	131	37,206	—	37,206
外部顧客への売上高	37,075	131	37,206	—	37,206
セグメント間の内部売上高 又は振替高	30	—	30	△30	—
計	37,106	131	37,237	△30	37,206
セグメント利益又は損失 (△)	10,834	△119	10,714	△484	10,230

(注) 1. セグメント利益又は損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用△484百万円であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3. 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれん償却額は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2026年3月1日 至 2026年5月31日)
減価償却費	759百万円	811百万円
のれん償却額	791百万円	810百万円

3. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

当第1四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごと及び品目別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	生産高(百万円)	前年同期比(%)
品目		
半導体・FPD関連装置事業		
半導体関連装置	18,320	123.5
FPD関連装置	1,652	194.0
計	19,972	127.3
ライフサイエンス事業	20	14.4
合計	19,993	126.3

(注) 金額は、製造原価によっております。

(2) 受注実績

当第1四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごと及び品目別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	受注高 (百万円)	前年同期比 (%)	受注残高 (百万円)	前年同期比 (%)
品目				
半導体・FPD関連装置事業				
半導体関連装置	42,030	188.4	62,253	132.7
分析装置	2,366	396.3	4,672	134.1
FPD関連装置	1,390	119.2	1,037	37.6
計	45,788	190.2	67,963	127.9
ライフサイエンス事業	741	502.8	772	539.1
合計	46,529	192.1	68,736	129.0

(注) 金額は、販売価格によっております。

(3) 販売実績

当第1四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごと及び品目別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	販売高(百万円)	前年同期比(%)
品目		
半導体・FPD関連装置事業		
半導体関連装置	30,239	107.1
分析装置	890	134.9
FPD関連装置	2,032	202.9
部品・修理 他	3,913	127.9
計	37,075	112.5
ライフサイエンス事業	131	118.8
合計	37,206	112.5

(注) 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先	前第1四半期連結累計期間		当第1四半期連結累計期間	
	販売高 (百万円)	割合 (%)	販売高 (百万円)	割合 (%)
Applied Materials, Inc.	5,058	15.3	8,130	21.9
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd.	6,123	18.5	6,768	18.2